

深圳佰维存储科技股份有限公司

投资者关系活动记录汇总表

(2025 年 5 月 14 日-5 月 15 日)

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐媒体采访 ☐新闻发布会 ☐专场机构交流会 ☐其他 ☐分析师会议 ☐业绩说明会 ☐路演活动 ☐现场参观
参与单位名称及人员姓名	华富基金 姚明昊、国联基金 陈祖睿、嘉实基金 陈俊杰、中银资管 周喆、浦银安盛 刘妍雪、远望角投资 张煜桐、诺安基金 王浩然、长江资管 严艺鸣、方正证券 金晶、诺安基金 陈衍鹏、长乐汇资本 赖建清、硕丰基金 盛军锋、诚朴资产 乔磊、国信证券 叶子、诺安基金 周靖翔、诺安基金 李迪
会议时间	2025 年 5 月 14 日 15: 00-16: 00 2025 年 5 月 15 日 10: 00-11: 00
会议地点	佰维存储三楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司管理层 董办工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	Q1. 2024 年四季度以来存储价格变化趋势如何？如何看待今年的价格趋势？ A1: 受全球宏观经济环境影响，存储价格从 2024 年第三季度开始逐季下滑，2024 年底部分原厂开始减产。从 2025 年第二季度开始，存储价格企稳回升，个别 LPDDR 物料出现紧缺态势，价格不断上涨。涨价一方面是由需求带来产业链库存去化至健康水平，另一方面是今年发布的 AI 产品在 PC 端对存储容量需求增加。2024 年存储市场表现为前高后低的情况，2025 年可能为前低后高的市场情况，但是由于关税政策的不确定性较强，未来市场走势难以独立清晰判断，目前来看产业链景气度在复苏。 Q2. 能否从下游应用领域拆分公司 2024 年的营收结构？ A2: 2024 年公司营业收入中，手机应用占比约 4-5 成，PC 应用占比约 3 成，智能穿戴应用占比约 1 成，其余为工车规应用、先进封测业务等。 Q3. 公司如何看待整个存储行业未来的发展趋势，作为存储解决方案商如何在竞争中保持竞争力？ A3: 我们认为存储行业未来有三个发展趋势。一是在云、边、端三个方面的 AI 深度应用。AI 要求存储具有大容量和高带宽的特点，边缘、端侧更强调存储低延迟、高性能和小尺寸，因此需在芯片设计、先进封装、测试设备等多个技术领域适应 AI 时代，做出满足更大容量、更高性能、更低功耗、更小尺寸综合要求的产品，通过差异化的解决方案提升方案价值。公司在 AI 端侧存储拥有较强的竞争力，主要得益于研发封测一体化布局，公司在主控芯片设计、解决方案研发和先进封测等领域的技术能力行业领先，可为 AI 端侧产品提供低功耗、高性

	能、小尺寸、大容量的存储解决方案；二是全球贸易摩擦使市场割裂，更加强调本地化交付能力，公司积极进行区域产能布局，在国内、巴西、印度、墨西哥等地布局，能够为公司带来新商业机会。三是存储与先进封装深度整合，先进封装成为技术前进的主要方向，公司能为终端客户和芯片设计厂商提供一站式解决方案，相较于提供单一的存储解决方案或者先进封测服务，具备综合的竞争力；公司提供的综合解决方案的价值量相比单独的先进封测服务，具有显著的放大效应，可以在 AI 时代持续创造价值。 Q4. 一季度利基产品涨价的原因是需求拉动还是原厂减产？产品涨价的持续性如何？展望二季度及未来，公司收入和毛利率的趋势是怎样的？ A4：由于存储市场较大，不同领域的玩家和供需格局不同。MLC 等产品涨价主要与原厂停产相关，市场供应大幅收缩，导致产品价格涨幅超 100%，公司有充分的储备，相关产品且可用于车规领域。在主流市场应用方面，涨价一方面是由于原厂减产调整，投资并扩张 HBM 产能，导致对其他产品产能扩张有所挤压，以及过去几年原厂对于 DRAM 和 NAND 的资本开支处于低位等因素有关，另一方面，与 AI 需求的拉动也有关系，AI 带动了存储产品的升级和扩容。从三月底开始，各大原厂都发布了涨价消息，价格涨幅较大，且行业预估今年会保持同期上涨态势。小容量产品因供给急速收缩，价格会维持在一定水平。从公司角度来看，一方面，价格的改善对公司产品有积极影响，另一方面，高端产品如 AI 眼镜、车规产品的毛利率较高，随着高端产品的出货量增加，后续公司毛利率有望提升。 Q5. 公司在 AI 端侧存储领域有先发优势，领先其他竞争对手，背后的核心竞争力是什么？ A5：AI 端侧场景要求存储产品具有高性能、低功耗的特性，过去的存储产品主要通过固件来优化性能，未来要通过主控芯片设计、固件算法与先进封装能力实现差异化竞争。在主控芯片设计方面，公司积极布局芯片研发与设计领域，将采用业界领先的架构设计，提升公司在 AI 手机、AI 穿戴、AI 智驾等领域的高端存储解决方案的产品竞争力；在固件算法方面，公司全面掌握了存储固件核心技术，有能力匹配各类客户典型应用场景，为客户提供创新、优质的存储解决方案；在先进封装方面，公司已掌握 16 层叠 Die、30~40 μm 超薄 Die、多芯片异构集成等先进工艺量产能力，达到国际一流水平，并构建 Bumping、RDL、Fanout 等晶圆级先进封装能力。通过主控芯片设计、固件算法与先进封装的协同效应，公司的存储解决方案实现行业领先的产品创新能力和可靠性，能够持续为终端客户提供适合 AI 端侧场景的高性能、低功耗的存储器产品。 Q6. 如何看待嵌入式存储本土化需求的成长，在 AI 端侧落地、本土化替代趋势下，解决方案厂商的增量空间如何？ A6：嵌入式存储产品迭代非常快，在接口性能容量、封装平台等方面变化较大，AI 时代对嵌入式存储产品提出了更高要求，尤其是 AI 端侧领域，先进封装的技术含量会越来越高。公司在 AI 端侧领域的产品线布局以高性能存储技术为核心，通过自研主控芯片、固件算法与先进封测能力实现差异化竞争，覆盖 AI 手机、AI PC、AI 眼镜、具身智能等多场景。2024 年，公司在 AI 新兴端侧（在非手机/PC 领域）合计营收超过 10 亿元，同比增长约 294%，2025 年公司预计在 AI 新
--	--

	兴端侧领域仍将保持良好的增长趋势。当前是产业创新爆发阶段，解决方案厂商能够凭借对市场需求的快速响应取得较好商业机会。从产业链重构角度看，在当前国际市场格局下，解决方案厂商通过全球产业布局，实现各区域市场的覆盖，并与原厂和下游客户实现丰富的协同合作，携手开拓市场。 Q7. 作为解决方案厂商，公司在存算一体领域的战略地位和不可替代的价值体现在哪里？ A7：存算一体是未来大的产业趋势，在很多场景下，系统厂商或大的设计厂商需要与合作伙伴协同开发存算一体解决方案，例如将逻辑单元与存储合并，可使芯片尺寸更小、功耗更低，提升边缘计算性能和客户体验。比如在自动驾驶的应用场景，客户需要定制化适配和成本可接受的方案，解决方案厂商能从中找到商业机会。公司积极推进与 IC 设计厂商、晶圆制造厂商以及终端客户等产业链伙伴的合作。针对边缘推理芯片、AI 手机、智能驾驶、AR/VR 等领域的存力需求，公司技术团队正在开发多种存算合封技术方案和先进存储芯片技术方案，覆盖了 Chiplet、RDL、Fanout、SiP 等多种先进封装形式，能够为客户提供整套的存储+晶圆级先进封装测试综合解决方案。
附件清单	无
日期	2025 年 5 月 14 日-5 月 15 日
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。